

軽量・低コスト放熱材 MIF

Lightweight & Low Cost, Thermal Conduction Material

開発の狙い Target

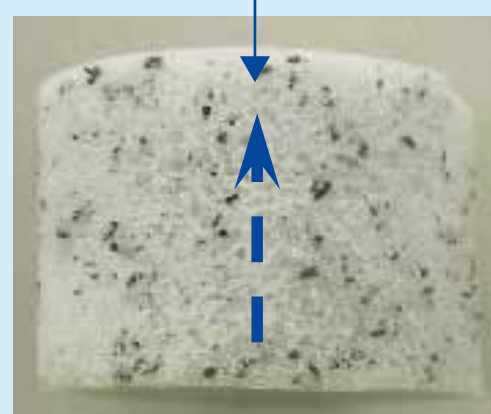
- シリコン放熱材の軽量・低コスト化
- Lightweight & low cost to silicone material

着眼点 Viewpoint

- 発泡ウレタンと熱伝導フィラーの組合せ
- Combination of polyurethane foam & heat conduction filler

コア技術【磁気誘導発泡 (MIF:Magnetic Induction Foaming)】 Patented

ウレタンを磁界中で発泡・成形 The urethane foam is molded in the magnetic field

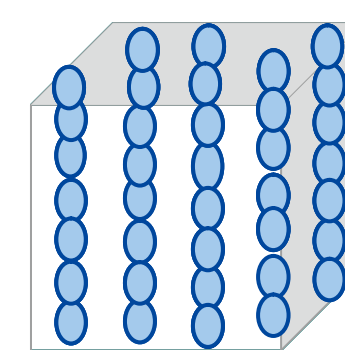


磁場無
With nomagnetic field
熱通過量 小
Heat transfer Few



磁場有
With magnetic field
熱通過量 大
Heat transfer Many

熱伝導フィラー
Thermal conduction filler



特定の磁場で起きる磁気誘導現象⇒鎖状クラスター構造をヒートブリッジにして熱を逃がす
Magnetic induction phenomenon that occurs in specific magnetic field
⇒ Chain clusters as heat bridge let heat out

特徴 Features

- ①放熱性 ⇒ 熱伝導フィラーを配向、効率良く放熱
 - ①Heat radiation ⇒ Thermal conduction filler arrangement enable efficient heat radiation
- ②軽量 ⇒ 40%軽量化 (シリコン放熱シート比)
 - ②Lightweight ⇒ 40% lighter (comparison with silicone material)
- ③フィット性 ⇒ 型成形ができ、形状自由度が高い
 - ③Flexibility ⇒ High flexibility performance, with mold forming
- ④防音性能 ⇒ 発泡ウレタンベースのため、吸音効果がある
 - ④Sound proofing ⇒ Performance of sound absorbing due to material based on polyurethane foam
- ⑤シロキサンフリー ⇒ 低分子量シロキサンの発生がない
 - ⑤Siloxane free ⇒ Low-molecular-weight siloxane free